

숫자로 보는

TI의 차기 300mm 유타주 리하이 웨이퍼 팩

110억
달러 투자

유타주 역사상
최대 규모의 경제적 투자

최대 **800**개의
새로운 일자리와
수 천개의 간접 고용 창출

2023년 말
착공 예정

빠르면
2026년
생산 시작

매일 수천만 개의
아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩
제조 예정

LEED Gold 표준을
준수하도록
설계

기존 팹보다
거의 **2배** 빠른 속도로 물 재활용

알파인 학군에 **900**만 달러 투자



TI는 유타주 리하이에서
반도체 제조의 새로운
시대를 구축하고 있습니다.

Visit [TI.com/Lehi](https://www.ti.com/Lehi)